PSS/S PSD/S 取扱説明書

目次

１．基板実装方法

２．洗浄方法

３．推奨パッド寸法

４．トレイ

＊注意　本取扱説明書は、標準品より変更のある項目のみ
記載しております。本取扱説明書に記載なき事項は
「PSS PSD シリーズ取扱説明書」をご参照下さい。

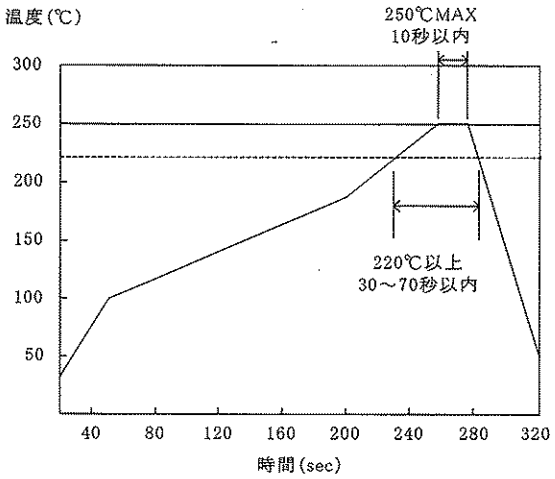
DWG. No. : C183-04-11/S		
APPD	CHK	DWG
N. Uesono 28. Mar. '05	S. Kamiyama 28. Mar. '05	M. Ono 28. Mar. '05

1．基板実装方法

1．自動実装について

1) 本製品を実装する場合には、必ず極性の判別を認識させた後、実装するようにして下さい。
2) 実装時には吸着ノズルの下死点を十分確認の上、実装して下さい。

2．リフロー条件



モジュールリード部で最も高温となるピンにて、250℃MAX10 秒以内、且つ 220℃以上 30～70 秒以内として下さい。最も高温となるピンは、アプリケーションの基板設計により異なります。最上面層に広いパターンが配線されるピンはより高温となり、多層基板の内層に接続されるピンは温度が上がりにくくなります。
表面積の広いパターンに接続されるピンの温度を十分確認の上、リフローを行って下さい。

注）モジュールリード部での熱容量はケース端子ピンが最も大きく、その他のピンは小さくなっております。ケース端子ピンの半田がつきづらい場合は、温度を高めに設定してください。他部品との兼ね合いで温度を上げられない場合は増し半田をして下さい。
規定の温度や時間を越えますと内部部品の信頼性が損なわれる場合がありますので必ずリフロー条件以下で御使用ください。
上記リフロープロファイル条件において、PSS/S・PSD/S モジュール内のはんだは溶融します。
リフロー炉内での搬送時は、モジュールが振動しないようにして下さい。

2．洗浄方法

本製品は、無洗浄フラックスを使用しておりますので洗浄しないことを推奨致します。
やむなく洗浄する場合は、端子のみ IPA にてハケ洗い洗浄をして下さい。
注）超音波洗浄はお避け下さい。

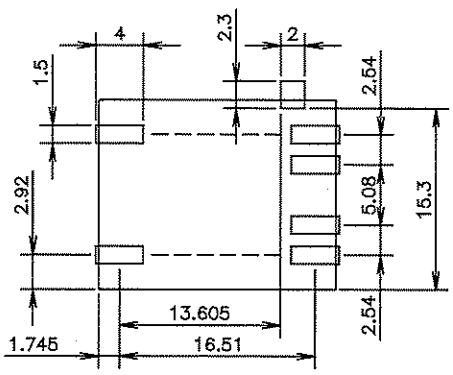
3．推奨パッド寸法

プリント基板のパッド寸法は、下記サイズを推奨致します。

タイプ	入出力端子ﾋﾟﾝ	ｹｰｽ端子ﾋﾟﾝ
端子形状	0.64×1.2mm	0.8×1.0mm
パッド寸法	1.5×4mm	2.3×2mm

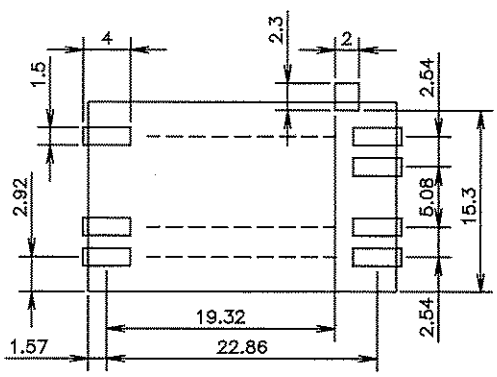
また、パッド位置については、下図をご参照下さい。

PSS1R5/S PSD1R5/S



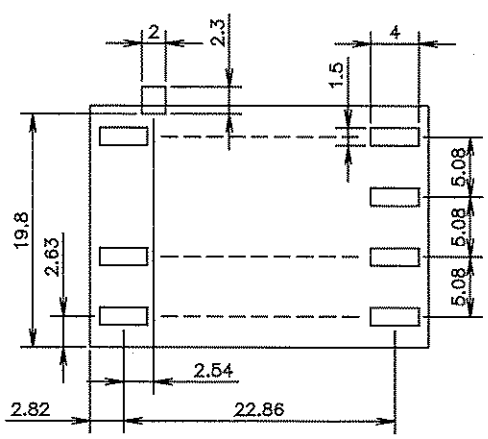
(TOP VIEW)

PSS3/S PSD3/S



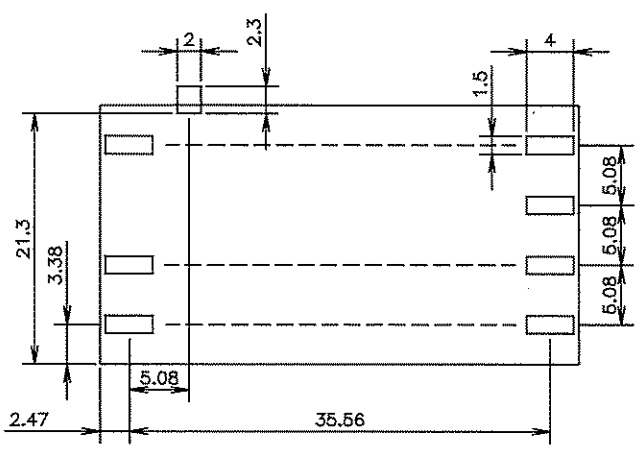
(TOP VIEW)

PSS6/S PSD6/S



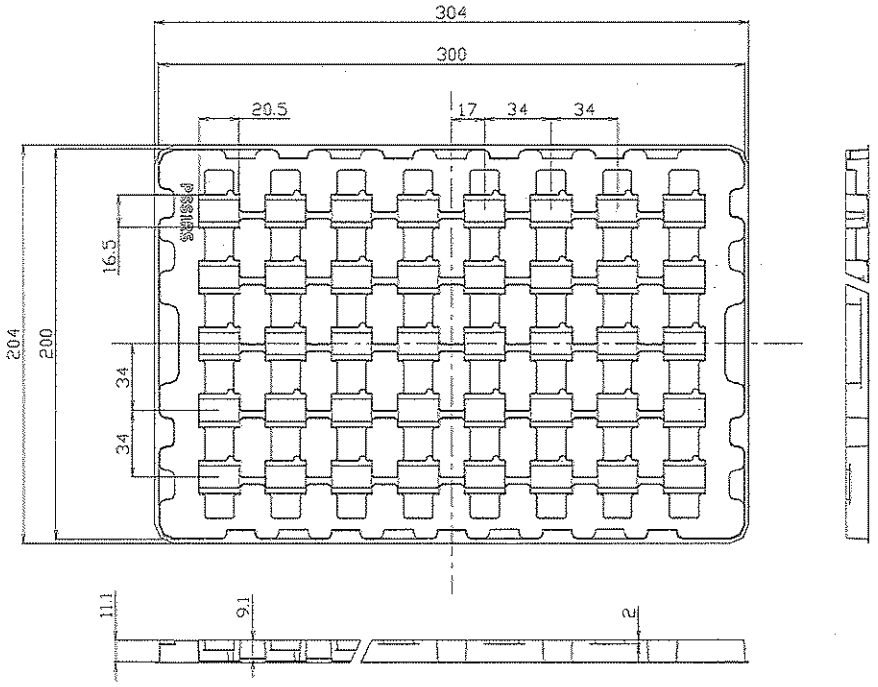
(TOP VIEW)

PSS10/S PSD10/S

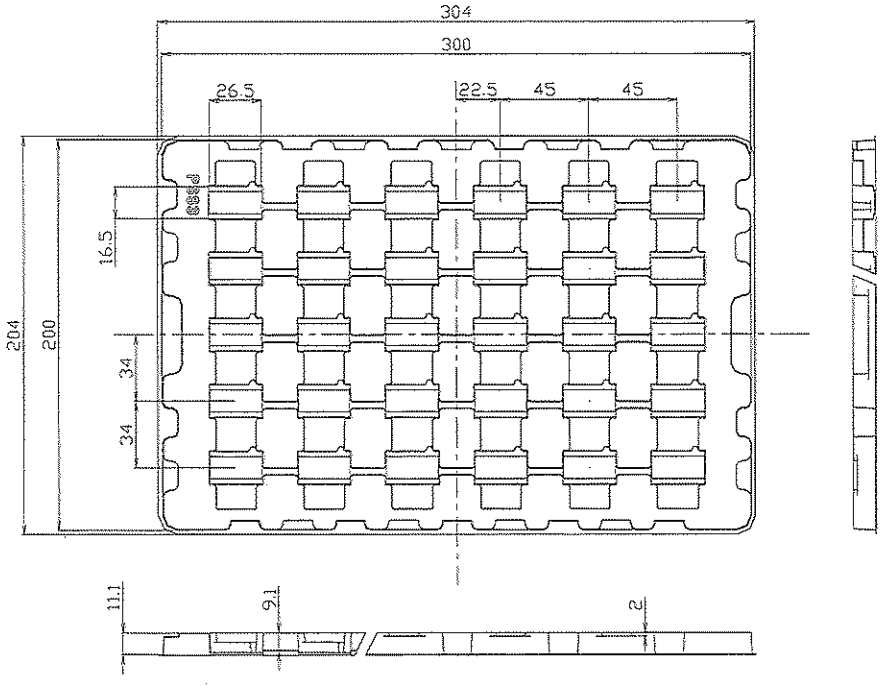


(TOP VIEW)

4. トレイ

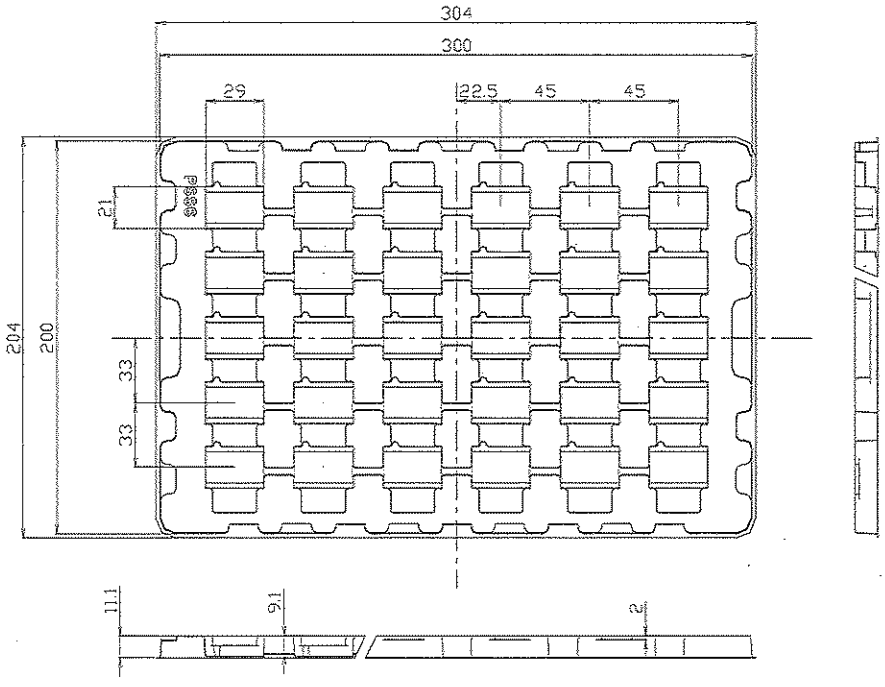


PSS1R5/S PSD1R5/S

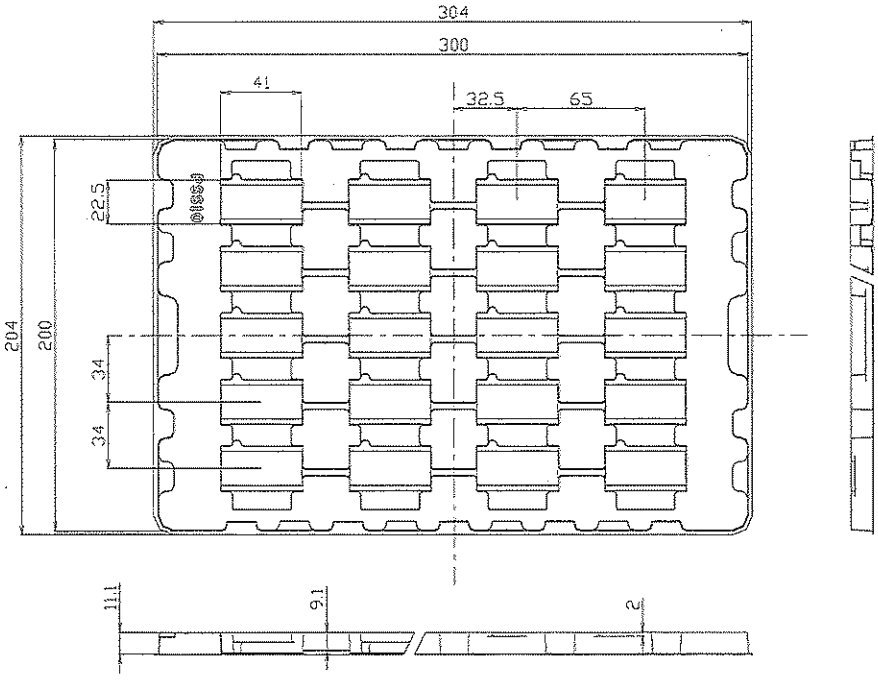


PSS3/S PSD3/S

(単位：m/m)



PSS6/S PSD6/S



PSS10/S PSD10/S

(単位：m/m)

仕様
材質：導電性ポリスチレン（PS）
表面抵抗：10^4～$10^5\Omega$
色：黒